

# 環境負荷化学物質含有量

環No.2019-44  
2019年4月11日

製品名 : MKY44-\*\*\*\*\*  
部品質量 (mg) : 245

株式会社ステップテクニカ 管理部  
E-mail kanri\_step@steptechnica.com

部位	素材・化学物質	CAS No.	質量 (mg)	部位含有率 (wt%)	全体含有率 (wt%)	使用目的
チップ	シリコン (Si)	7440-21-3	31.98312	100	13.0543	素子材料
チップマウント	銀 (Ag)	7440-22-4	0.39466	75.0005	0.1611	導電性材料
	エポキシ樹脂 (EP)	---	0.13155	24.9995	0.0537	接合材料
リードフレーム	銅 (Cu)	7440-50-8	96.11617	100	39.2312	フレーム材料
ワイヤ	金 (Au)	7440-57-5	1.81806	100	0.7421	配線
外部端子メッキ	パラジウム (Pd)	7440-05-3	0.12116	7.8	0.0495	端子表面処理材料
	金 (Au)	7440-57-5	0.0466	3	0.019	端子表面処理材料
	ニッケル (Ni)	7440-02-0	1.38868	89.2	0.5668	下地メッキ
パッケージ	三酸化アンチモン (Sb2O3)	1309-64-4	2.26	2	0.9224	封止樹脂難燃助剤
	PBB, PBDE以外の臭素系難燃剤	---	1.695	1.5	0.6918	封止樹脂難燃剤
	エポキシ樹脂 (EP)	---	19.775	17.5	8.0714	封止樹脂材料
	シリカ (SiO2)	60676-86-0	89.27	79	36.4367	封止樹脂材料
		含有量合計	245		100	